

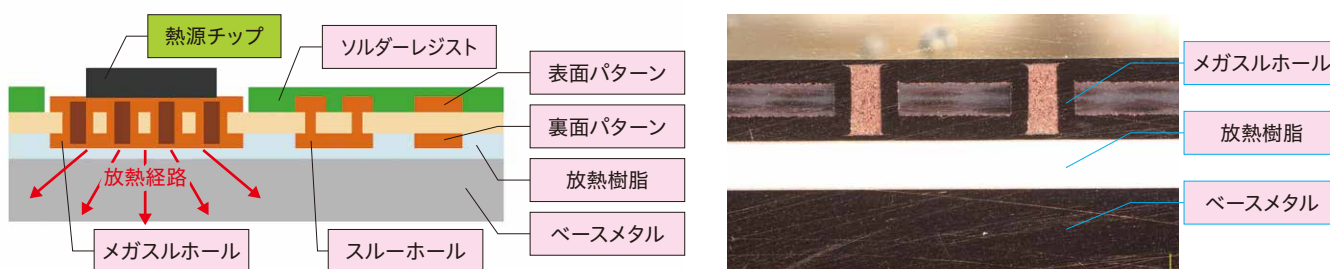
多層メタルベース基板

Metal base PCB with multi layer circuit

特長 Features

- 制御基板とパワー基板を一体化する事で、省スペース化とCD効果を実現
- 絶縁性の高い放熱樹脂を介して、ベースメタルへ効率の良い放熱経路を形成
- 回路を多層化することで制御回路とパワー回路を一体化した高密度実装設計が可能

構造図 Structure



熱シミュレーション比較

FR-4複層基板構造	通常スルーホール	MegaTH		
熱抵抗(基板)	4.70°C/W	3.59°C/W	2.05°C/W	1.58°C/W
熱源	4mm ² 、20W			
ベースメタル	アルミ合金(A5052)			
放熱樹脂熱伝導率	1.5W/m·k	4.0W/m·k*1	11W/m·k*1	

*1:高放熱材開発中

R&D 導通構造メタルベース基板

- 表面パターンと銅ベースをスルーホールを介してGND接続
- 高温BDV(175°C/Break Down Voltage:絶縁破壊電圧)対応

